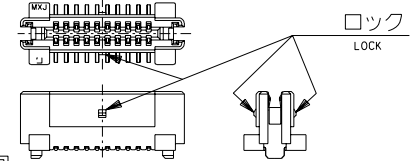


推奨基板寸法 (20, 60, 80, 84, 100, 120, 140極)
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (20,60,80,84,100,120,140 CKTS.)

推奨基板寸法 (34, 50, 66極)
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (34,50,66 CKTS.)

注) NOTES

- 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りLCP、白色、UL94V-0
HOUSING: F.LCP, WHITE, UL94V-0
ターミナル: 燐青銅 (t=0.2)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE
- メッキ仕様 PLATING
接点部: 金メッキ 0.25 マイクロメートル以上。
CONTACT AREA: GOLD 0.25 MICROMETER MINIMUM.
半田付け部: 錫メッキ 1.0 マイクロメートル以上。
SOLDER TAIL AREA: TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM.
下地メッキ: ニッケルメッキ 2.0 マイクロメートル以上。
UNDER-PLATING: NICKEL 2.0 MICROMETER MINIMUM.
- 推奨基板厚 RECOMMENDED PCB THICKNESS
1.0±0.1mm MIN.
- テールのバラツキ寸法 TAIL COPLANARITY
テールは、Y面を基準とし、上へ0.02 下へ0.15の範囲にあり、目付テール平坦度は0.15とする。
TAILS TO BE WITHIN 0.02 UPWARD AND 0.15 DOWNWARD FROM Y-DATUM PLANE, AND TAIL COPLANARITY TO BE 0.15.
- ロックは、20, 34, 50極に設置する。
LOCK TO BE ADDED TO 20, 34 AND 50 CKTS.
- 梱包 PACKAGING
本製品はスティック梱包とし梱包後の MATERIAL NO. は 52584-***79 とする。
THIS PRODUCTS TO BE PACKED IN TUBE. MATERIAL NO.: 52584-***79
- 同一基板内に複数個 (2ヶ以上) の使用は避けてください。
MXJ DOSE NOT RECOMMEND THE USAGE OF TWO OR MORE OF THESE CONNECTORS BETWEEN A SINGLE PAIR OF P.C.BOARD.
- 本製品は 52584-***0 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52584-***0.



73.5	70.2	75.9	69	52584-1408	140
63.5	60.2	65.9	59	52584-1208	120
53.5	50.2	55.9	49	52584-1008	100
45.5	42.2	47.9	41	52584-0848	84
43.5	40.2	45.9	39	52584-0808	80
36.5	33.2	38.9	32	52584-0668	66
33.5	30.2	35.9	29	52584-0608	60
28.5	25.2	30.9	24	52584-0508	50
20.5	17.2	22.9	16	52584-0348	34
13.5	10.2	15.9	9	52584-0208	20
D	C	B	(A)	MATERIAL NO.	極数 NO. OF CKTS.

角度 ANGLE	±3°	材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社 REVISE ONLY ON CAD SYSTEM TITLE 名称 1.0 B-T0-B S/T REC.HS'G ASS'Y -LEAD FREE- DWG. NO. SD-52584-007 REV 0
30以上 OVER	+0.3	仕上げ FINISH	注参照 SEE NOTES	
10以上 OVER 30 UNDER	+0.25	適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—	
10 UNDER	+0.2	被覆外径 INS. RANGE	—#—	
一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK. DATE	DRAWN BY 04/03/22 H.KAWABATA CHK'D BY 04/03/22 K.TOJO APP'D BY 04/03/22 M.SASAO 尺度 SCALE —#—

7

6

5

4

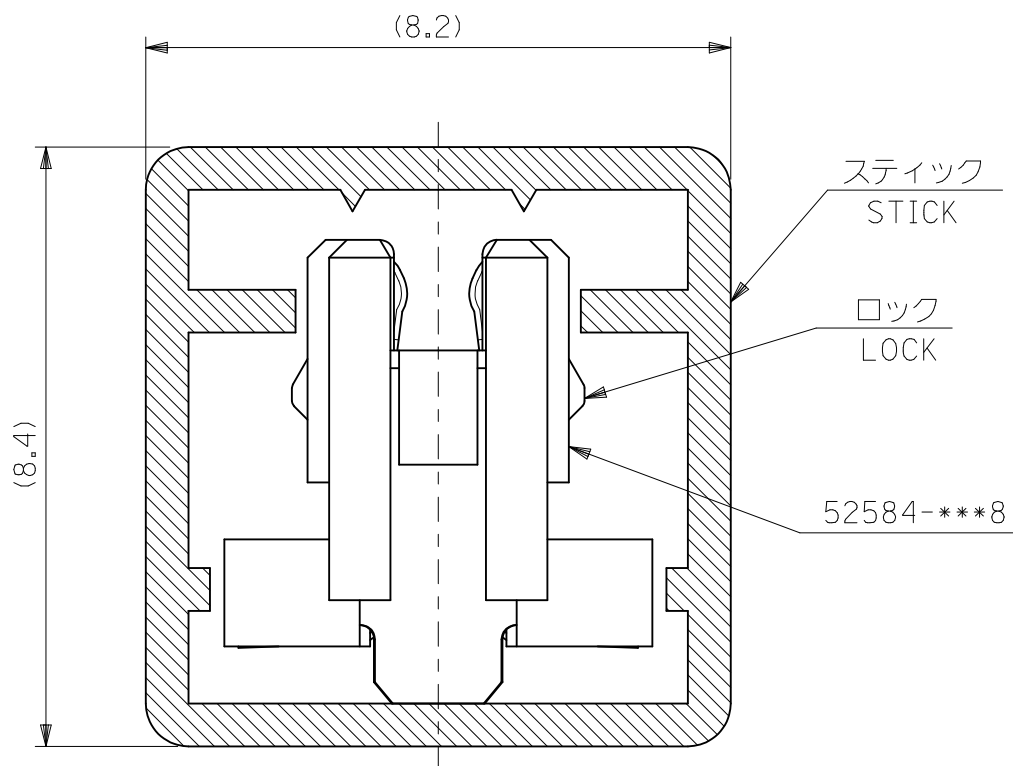
3

2

1

注記
NOTES

- スティック両端はキャップ止め。
BOTH ENDS WITH CAPS.
- 全 長: 600 ± 2
TOTAL LENGTH
- 肉 厚: 0.6 ± 0.2
THICKNESS
- ロックは、20, 34, 50極に設置。
LOCK TO BE ADDED TO 20, 34
AND 50 CKTS.
- 本製品は52584-***9の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52584-***9.



7	52584-1479	140	
8	52584-1279	120	
10	52584-1079	100	
12	52584-0879	80	
15	52584-0679	60	
52584-***79	18	52584-0579	50
MODEL No.	梱包数 QUANTITY	MATERIAL No.	極数 NO. OF CKTS.

MATERIAL

スティック: ポリ塩化ビニル
STICK: P.V.C

REVISED

EC NO: J2011-1534
DRWN: TKAKIMOTO 2011/05/18
CHKD: THARUYAMA 2011/05/18
APPR: HIRATA 2012/06/07

QUALITY SYMBOLS
 = CRITICAL
 = MAJOR
 = ZERO DEFECT
 = S.P.C.

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

DIMENSIONS \pm ---ANGULAR ± 3 °DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONSDIMENSION STYLE
MM ONLYDRAWN BY
HKAWABATADATE
'04/03/22CHECKED BY
KTOJODATE
'04/03/22APPROVED BY
MSASAODATE
'04/03/22

MATERIAL NO.

SEE TABLE

SIZE
A4SCALE

TITLE

DESIGN UNITS
METRIC

52584-***8
STICK PACKAGING
-LEAD FREE-

molex

DOCUMENT NO.

SD-52584-008

THIRD ANGLE
PROJECTION

SHEET NO.

1 OF 1

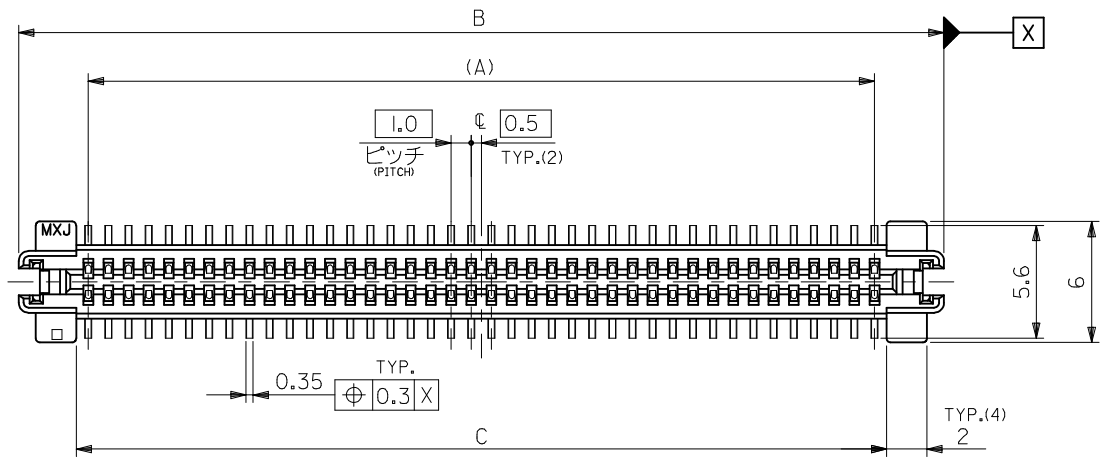
6

5

4

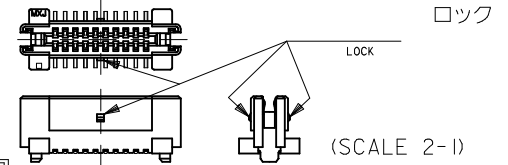
3

2

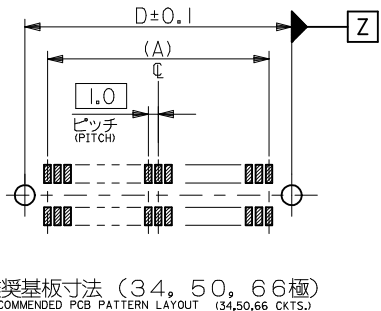
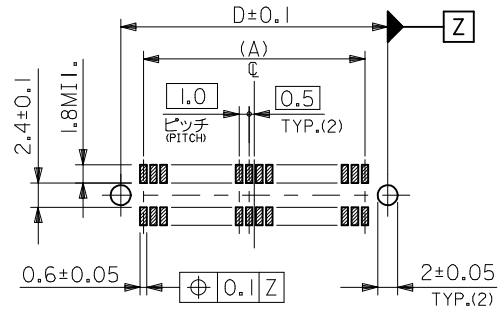
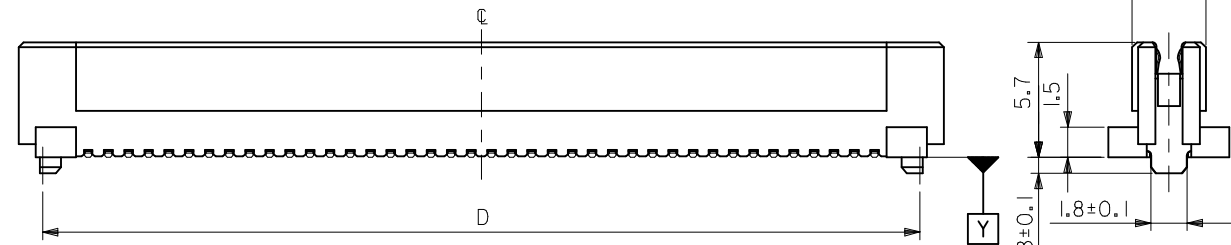


注) NOTES

1. 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入り LCP、白色、UL 94V-0
ターミナル: 燐青銅 (t = 0.2)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE
2. メッキ仕様 PLATING
接点部: 金メッキ 0.25 μm MIN.
CONTACT AREA: GOLD 0.25 μm MIN.
半田付け部: 半田メッキ 1.0 μm MIN.
SOLDER TAIL AREA: TIN-LEAD 1.0 μm MIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 2.0 μm MIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 2.0 μm MIN.
3. 推奨基板厚 RECOMMENDED PCB THICKNESS
1.0 ± 0.1 mm MIN.
4. テールのバラツキ寸法 TAIL COPLANARITY
テールは、Y面を基準とし、上へ 0.02 下へ 0.15 の範囲にあり、目つテール平坦度は 0.15 とする。
TAILS TO BE WITHIN 0.02 UPWARD AND 0.15 DOWNWARD FROM Y-DATUM PLANE. AND TAIL COPLANARITY TO BE 0.15.
5. ロックは、20, 34, 50 極に設置する。
LOCK TO BE ADDED TO 20, 34 AND 50 CKTS.



6. 梱包 PACKAGING
本製品はスティック梱包とし梱包後の ENG. NO. は 52584-***9 とする。
THIS PRODUCTS TO BE PACKED IN TUBE. ENG. NO.: 52584-***9
7. 同一基板内に複数個 (2ヶ以上) の使用は避けてください。
MXJ DOSE NOT RECOMMEND THE USAGE OF TWO OR MORE OF THESE CONNECTORS BETWEEN A SINGLE PAIR OF P.C.B.OARD.



推奨基板寸法 (20, 60, 80, 84, 100, 120, 140 極)
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (20,60,80,84,100,120,140 CKTS.)
(SCALE 2-1)

推奨基板寸法 (34, 50, 66 極)
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (34,50,66 CKTS.)
(SCALE 2-1)

73.5	70.2	75.9	69	52584-1400	140
63.5	60.2	65.9	59	52584-1200	120
36.5	33.2	38.9	32	52584-0660	66
33.5	30.2	35.9	29	52584-0600	60
28.5	25.2	30.9	24	52584-0500	50
20.5	17.2	22.9	16	52584-0340	34
13.5	10.2	15.9	9	52584-0200	20
D	C	B	(A)	ENG. NO.	極数 NO. OF CKTS.

REVISED EC NO: J	2008/11/06 DRWN: YOSHIDAM	DESCRIPTION REV	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 4:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
	2009/03/23 CHKD: THARUYAMA		10 UNDER ±0.2	DRAWN BY J. MIYAZAWA	DATE	TITLE 1.0 B-T0-B S/T REC. HSG ASSY		MOLEX INCORPORATED		
	2009/03/25 APPR: THARUYAMA		10 OVER 30 UNDER ±0.25	CHECKED BY M. SASAO	DATE	DOCUMENT NO. SD-52584-009				SHEET NO. 1 OF 1
			30 OVER ±0.3	APPROVED BY H. IKESUGI	DATE	SEE TABLE				
			ANGULAR ±3 °	MATERIAL NO.						
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS			SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				